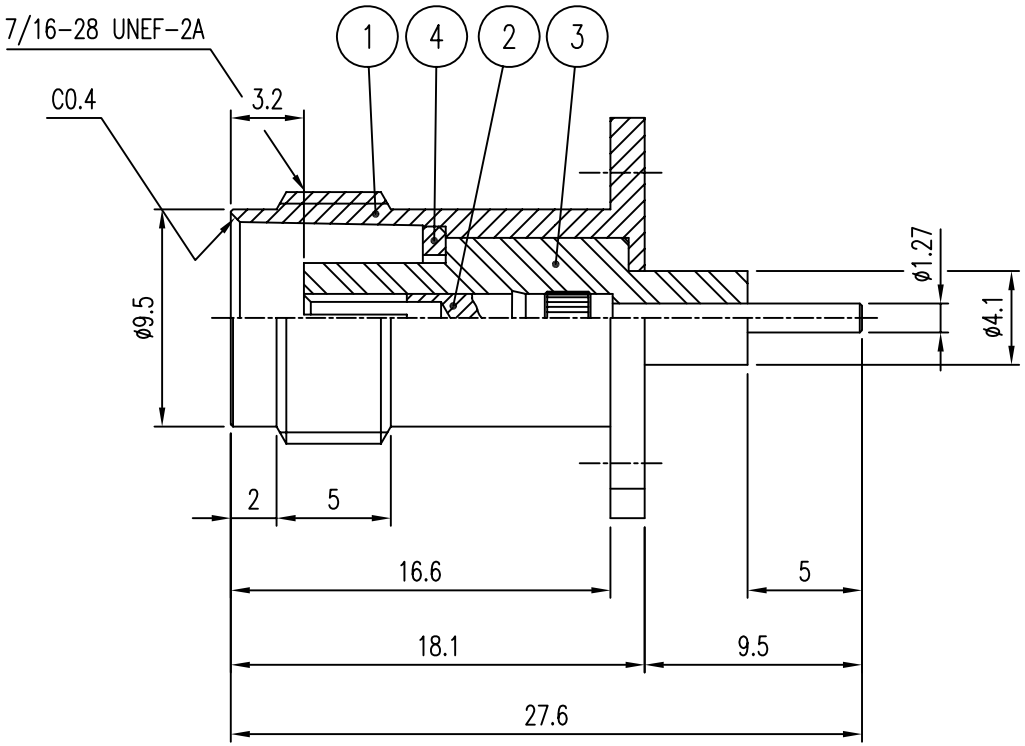
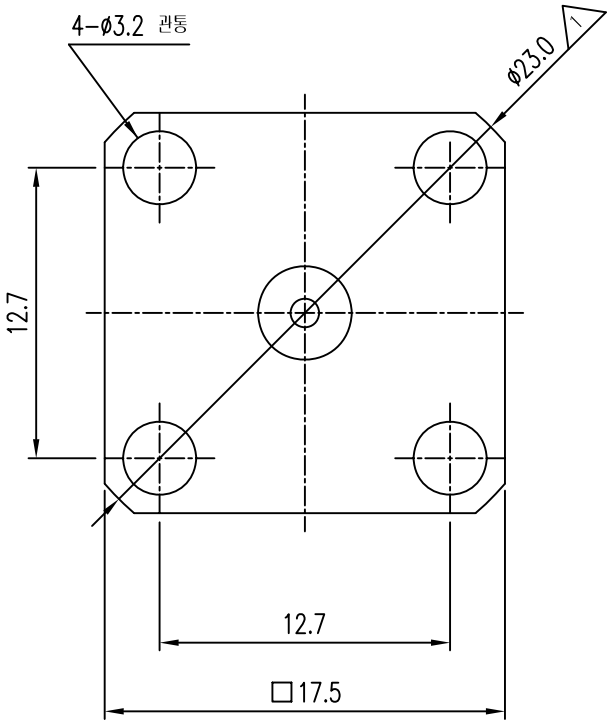
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	사각 플랜지 외곽 R1.0 -> ⌀23.0 변경	은선영	김인철	2020. 10. 28.
2	조립공차 ±0.1 → ±0.2 변경	은선영	김인철	2020. 12. 07.





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
4	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00051-5/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01093-N/1
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01279-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01623-5/1

1

대체가능재질

공통공차

.* ±0.2

.** ±0.05

2

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2007. 11. 21.

승인

검도

재도

작성부서 연 구 소

척도 1.5/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 TNC-J-H4-R

A4

도번 CN00917-7/1